



TIC® 800H 系列是一种高性能、高性价比的导热界面材料，具备独特的晶粒定向结构，能够精确贴合器件表面，有效放大热传导路径与转换效率。在超过其相变温度50°C时，材料开始软化并发生相变，能够充分填充器件之间微小且不规则的接触缝隙，形成低热阻的界面，显著提升散热性能。

特性

- 》低热阻
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》低压力应用环境

应用

- 》功率转换设备
- 》电源与车用蓄电池
- 》大型通信开关硬件
- 》LED电视，灯具
- 》笔记本电脑

TIC® 800H 系列特性表

产品名称	TIC® 808H	TIC® 810H	TIC® 812H	测试标准
颜色	灰色			目视
厚度 (inch/mm)	0.008" (0.200)	0.010" (0.250)	0.012" (0.300)	ASTM D374
密度 (g/cc)	2.7			ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 125			兆科测试
相变温度 (°C)	50~60			兆科测试
导热系数 (W/mK)	7.5			ASTM D5470
热阻抗 (°C·in ² /W) @ 10 psi	0.018	0.019	0.021	ASTM D5470
热阻抗 (°C·in ² /W) @ 50 psi	0.013	0.014	0.015	ASTM D5470

标准厚度: 0.008" (0.20 mm) , 0.010" (0.25 mm) , 0.012" (0.30 mm) 如需不同厚度请联系本公司。

标准尺寸: 10" × 16" (254 mm × 406 mm) 。

压敏黏合剂: 不适用于TIC®800H 系列产品。补强材料: 无需补强材料。

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
 台湾: +886-2-2277-1007
 加拿大: +001-604-2998559
 越南: +84-396852859

service@ziitek.com
 www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd(兆科科技有限公司)及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek(兆科)本公司不对产品的适用性，可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek(兆科)及其标志为公司或关联公司所有。

